

# LPTBG32B

## 产品特性 Product Features :

芯片尺寸 Dimensions : 32mil x 32mil  
(800±50um x 800±50um)

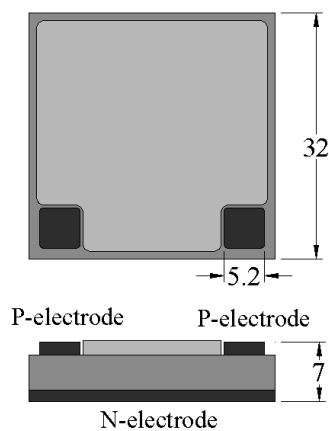
芯片厚度 Chip Thickness : 7mil(175±20um)

焊盘尺寸 Pad Size : 5.2mil(130±10um)

焊盘金属 Pad Material :

N 焊盘 (N PAD) : Au

P 焊盘 (P PAD) : Au



单位: mil

### 光电性能 (Electronic Parameters), TA=25°C

参数 Parameters	符号 Symbol	条件 Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
开启电压 Turn-On Voltage	Vf1	If=10μA	1.9	---	2.8	V
工作电压 Forward Voltage	Vf2	If=350mA	2.8	3.1	3.3	V
反向漏电流 Reverse Leakage Current	IR	Vr=5V	---	---	2	μA
主波长 Dominate Wavelength	λd	If=350mA	445	---	465	nm
半波宽度 FWHM	Δλ	If=350mA	---	---	30	nm
光功率 Luminous Power	Po	If=350mA	450	---	640	mW